

# Aufruf zur Interessensbekundung für Projekte unter Säule 2 des Chips Act

Aufrufe zu Interessensbekundungen dienen der Erhebung der generellen Situation in Österreich zu einem möglichen First of a Kind Project unter Säule 2 des Chips-Act. Durch die Meldung eines potenziellen Vorhabens und eines möglichen Förderbedarfs bei dieser Interessensbekundung entsteht kein Förderanspruch. Es wird explizit darauf hingewiesen, dass eine etwaige Projektförderung unter dem Vorbehalt einer Entscheidung der Bundesregierung zur Teilnahme auf Basis der Entsprechung zu nationalen Strategien, einer fachlichen Bewertung, der verfügbaren Budgetmittel und der beihilferechtlichen Genehmigung der Europäischen Kommission steht. Sollte das Vorhaben oder Teile des Vorhabens im Rahmen von konventionellen Förderprogrammen förderbar sein, obliegt die Entscheidung für einen alternativen Förderpfad der Bundesregierung. Es werden zudem keinerlei Garantien für die finale Höhe einer allfälligen staatlichen Beihilfe ausgesprochen.

## **Aufruf zur Interessensbekundung vom 13. Juli 2023**

Abgabe von Projektskizzen bis einschließlich 21. August 2023, 17:00 Uhr  
(Technischer Einreich-Support ist bis 21. August 2023 um 13:00 Uhr  
sichergestellt)

## **Impressum**

Medieninhaber, Verleger und Herausgeber:

Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft, Stubenring 1, 1010 Wien

### **Strategische , prozedurale und inhaltliche Verantwortung:**

Mag. Thomas Saghi - Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft - Abteilung IV/5

### **Operative Abwicklung:**

Austria Wirtschaftsservice Gesellschaft mbH, Walcherstraße 11A, 1020 Wien

Wien, 13. Juli 2023

## Inhalt

<b>1 Motivation .....</b>	<b>4</b>
<b>2 Inhaltlicher Fokus .....</b>	<b>6</b>
<b>3 Teilnahmevoraussetzungen .....</b>	<b>10</b>
Einreichen einer Projektskizze.....	10
Inhalt einer Projektbeschreibung.....	10
<b>4 Weiterführende Informationen .....</b>	<b>12</b>
Wichtige Links.....	12
Rechtsgrundlage.....	12
Beratung.....	13

# 1 Motivation

In ihrem Regierungsprogramm für 2020 bis 2024 hat die Bundesregierung die zentrale Bedeutung der Mikroelektronik für die österreichische Standort- und Industriepolitik hervorgehoben. Österreich verfügt über eine ungewöhnlich hohe Dichte an international agierenden und forschungsintensiven Unternehmen, die entlang der Wertschöpfungskette der Halbleiter-, Zuliefer- und Anwenderindustrie tätig sind und sich durch hohe Wirtschaftsleistung auszeichnen.

Die Stärkefelder des österreichischen Halbleiter- und Elektronikstandortes liegen vor allem in folgenden Kompetenzfeldern: Leistungselektronik, smarte Sensorik, Sicherheit in der digitalisierten Welt und Design.

Österreich ist Europas Nummer 1 im Bereich der elektronischen Bauelemente in relativen Zahlen, bezogen auf die Größe des Landes:

- **Platz 1 hinsichtlich Anteile an der Gesamtwertschöpfung**
- **Platz 1 hinsichtlich Anteile an der Gesamtbeschäftigung**
- **Platz 1 hinsichtlich Anteile in der unternehmerischen Forschung & Entwicklung**

Diese Position gilt es im internationalen Wettbewerb zu stärken und weiter auszubauen.

Vor dem Hintergrund der weltweiten Verknappung von Chips legte die Europäische Kommission im Februar 2022 einen Vorschlag für einen **EU-Chip-Rechtsakt** vor, der die gesamte EU-Chip-Wertschöpfungskette stärken soll. Dieser Rechtsakt ist in 3 Säulen strukturiert:

- **Säule 1** dient der Förderung des Aufbaus groß angelegter technologischer Kapazitäten und Innovationen im Ökosystem der EU-Halbleiterhersteller und soll unter dem Titel "Chips für Europa" den Übergang "vom Labor zur Fertigung" verbessern.
- **Säule 2** schafft einen Rahmen zur Verbesserung der Versorgungssicherheit mit Chips in der EU, indem in- und ausländische Investitionen angezogen und der Aufbau großer Produktionskapazitäten unterstützt werden.
- **Säule 3** dient dem Aufbau eines Mechanismus für die Überwachung und Krisenreaktion entlang der gesamten Lieferkette.

Dabei soll der EU-Anteil an der globalen **Chips-Produktion von aktuell unter 10% bis 2030 auf 20% verdoppelt** werden. Es wird erwartet, dass der Chipmarkt stark weiterwachsen wird.

**Am 11. Juli 2023 erfolgte die Annahme des Chips Act im Europäischen Parlament - [siehe hier](#).**

**Die Annahme durch den Rat der Europäischen Union ist für September 2023 vorgesehen.**

## 2 Inhaltlicher Fokus

Gegenstand dieses Aufrufs zur Interessensbekundung sind Projekte im Rahmen der **Säule 2 des europäischen Chips Act**. Der Rahmen ermöglicht die öffentliche Unterstützung direkt auf Basis des Art. 107(3)c VAEU für zwei neue Arten innovativer Produktionsanlagen, die in der EU die ersten ihrer Art sind (first of a kind (FOAK)). Diese neuen Einrichtungen sind einerseits „Integrierte Produktionsanlagen - IPFs“, die Chips für ihre eigenen Märkte entwerfen und produzieren würden und andererseits „Offene EU-Foundries - OEUFs“, die einen erheblichen Teil ihrer Produktionskapazität für andere industrielle Akteure bereitstellen würden.

### 1. Integrierte Produktionsstätten

Integrierte Produktionsstätten sind neuartige Anlagen für die Fertigung und den Entwurf von Halbleitern, oder für die Herstellung von Ausrüstung oder Schlüsselkomponenten für solche Ausrüstung, die überwiegend in der Halbleiterfertigung in der Union verwendet werden, was auch andere Stufen der Lieferkette einbeziehen kann, welche zur Versorgungssicherheit und zur Resilienz des Halbleiter-Ökosystems in der Union beitragen. Gegebenenfalls können integrierte Produktionsstätten zusätzlich zur Sicherheit der globalen Halbleiter-Lieferketten beitragen.

Eine integrierte Produktionsstätte muss folgende **Anforderungen** erfüllen:

Ihre Einrichtung hat auf die Halbleiter-Wertschöpfungskette der Union im Hinblick darauf, die Versorgungssicherheit und Resilienz des Halbleiter-Ökosystems, einschließlich des Wachstums von Start-ups und KMU, sicherzustellen und zum grünen und digitalen Wandel der Union beizutragen, mittel- bis langfristig eine eindeutig positive Auswirkung mit Ausstrahlungseffekten über das Unternehmen oder den betreffenden Mitgliedstaat hinaus;

- a. sie leistet Gewähr dafür, dass sie nicht der extraterritorialen Anwendung gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen von Drittländern in einer Weise unterworfen ist, die die Fähigkeit des Unternehmens, seinen im Chips Act festgelegten Verpflichtungen nachzukommen, untergraben könnte, und sie verpflichtet sich, die Kommission zu unterrichten, wenn eine solche Verpflichtung entstehen sollte;
- b. sie investiert in der Union in kontinuierliche Innovation, um konkrete Fortschritte im Bereich der Halbleitertechnologie zu erzielen oder Technologien der nächsten Generation vorzubereiten;

- c. sie unterstützt die Talentpipeline der Union durch die Entwicklung und den Einsatz von Bildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen und durch die Ausweitung des Pools an qualifizierten Arbeitskräften.
- d. Für die Zwecke von Investitionen in kontinuierliche Innovation erhält die integrierte Produktionsstätte bevorzugten Zugang zu den auf Basis des Chips Act einzurichtenden Pilotanlagen. Durch einen solchen bevorzugten Zugang wird der effektive Zugang anderer interessierter Unternehmen, insbesondere Start-ups und KMU, zu den Pilotanlagen unter fairen Bedingungen weder ausgeschlossen noch verhindert.

## **2. Offene EU-Fertigungsbetriebe (Auftragsfertigung)**

Offene EU-Fertigungsbetriebe sind neuartige Anlagen oder Halbleiterfertigungsanlagen in der Union, die von ihnen unabhängigen Unternehmen Produktionskapazität anbieten und somit zur Versorgungssicherheit für den Binnenmarkt und zur Resilienz des Halbleiter-Ökosystems in der Union beitragen. Offene EU-Fertigungsbetriebe können gegebenenfalls zur Sicherheit der globalen Halbleiter-Lieferkette beitragen.

Ein offener EU-Fertigungsbetrieb muss folgende Anforderungen erfüllen:

- a. seine Einrichtung hat auf die Halbleiter-Wertschöpfungskette der Union im Hinblick darauf, die Versorgungssicherheit und Resilienz des Halbleiter-Ökosystems, einschließlich des Wachstums von Start-ups und KMU, sicherzustellen und zum grünen und digitalen Wandel der Union beizutragen, mittel- bis langfristig eindeutig positive Auswirkungen mit Ausstrahlungseffekten über das Unternehmen oder den betreffenden Mitgliedstaat hinaus, wobei insbesondere berücksichtigt wird, inwieweit er von der Anlage unabhängigen Unternehmen Produktionskapazität im Front-End- oder Back-End-Bereich oder beidem anbietet, sofern eine ausreichende Nachfrage besteht;
- b. er leistet Gewähr dafür, dass er nicht der extraterritorialen Anwendung gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen von Drittländern in einer Weise unterworfen ist, die die Fähigkeit des Unternehmens, seinen im Chips Act festgelegten Verpflichtungen nachzukommen, untergraben könnte, und er verpflichtet sich, die Kommission zu unterrichten, wenn eine solche Verpflichtung entstehen sollte;
- c. er investiert in der Europäischen Union in kontinuierliche Innovation, um konkrete Fortschritte im Bereich der Halbleitertechnologie zu erzielen oder Technologien der nächsten Generation vorzubereiten;
- d. er unterstützt die Talentpipeline der Union durch die Entwicklung und den Einsatz von Bildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen und durch die Ausweitung des Pools an qualifizierten Arbeitskräften.

Bietet ein offener EU-Fertigungsbetrieb Unternehmen, die von dem Betreiber der Anlage unabhängig sind, Produktionskapazität an, so nimmt er eine angemessene und wirksame funktionale Trennung der Entwurfs- und Fertigungsprozesse vor und erhält diese aufrecht, um den Schutz der in jeder Stufe gewonnenen Informationen sicherzustellen.

Für die Zwecke von Investitionen in die kontinuierliche Innovation erhält der offene EU-Fertigungsbetrieb bevorzugten Zugang zu den auf Basis des Chips Act einzurichtenden Pilotanlagen. Durch einen solchen bevorzugten Zugang wird der effektive Zugang anderer interessierter Unternehmen, insbesondere Start-ups und KMU, zu den Pilotanlagen unter fairen Bedingungen weder ausgeschlossen noch verhindert.

# 3 Teilnahmevoraussetzungen

## Einreichen einer Projektskizze

Der Prozess bis zur erfolgreichen Anerkennung ist grundsätzlich in drei Phasen von der Interessensbekundung bis zur Genehmigung unterteilt:

Tabelle 1: Phasen

Phase	Prozessschritt
Phase 1	Interessensbekundung inkl. Projektportfolio und Auswahl auf nationaler Ebene
Phase 2	Anmeldung als „First of A Kind“ Produktionsanlage bei der Europäischen Kommission sowie Notifizierung des Projektes bei Europäischen Kommission
Phase 3	Abschluss des Förderungsvertrags mit der Austria Wirtschaftsservice

Dieser Aufruf zur Interessensbekundung ist Phase 1 des Prozesses. Der öffentliche Aufruf zur Abgabe einer Interessensbekundung dient zur Erhebung der generellen Situation in Österreich. Die Einreichung einer Projektskizze auf nationaler Ebene ist die Voraussetzung für die Anmeldung des Projektes als „First of A Kind“ bei der Europäischen Union (Stufe 2) und beinhaltet vertrauliche Projekteinheiten sowie weitere Informationen zur Organisation und Strukturierung des Projektes. **Damit begründet sich noch kein Anspruch auf eine Förderung.**

## Inhalt einer Projektbeschreibung

Eine detaillierte Projektbeschreibung in Phase 1 besteht aus einem vorläufigen Projekt-Portfolio. Ein Link zur Dokumentenvorlage für die Unterlagen der detaillierten Projektbeschreibung wird bereitgestellt via [ausgefülltes Template](#).

Im **Projekt-Portfolio** sind Details zum Vorhaben möglichst umfänglich zu beschreiben. Es ist in englischer Sprache beizubringen und enthält folgende Kapitel:

- Kurze Projektbeschreibung
- Investitionsvolumen und Budget sowie Beihilfenhöhe

- Erklärung zur Berechnungsgrundlage der Finanzierungslücke
- Angaben zur Begründung des Status als First of a Kind (IPF bzw. OEUF)
- Kontaktinformationen

Eine Finanzierungslücke wird berechnet, indem die erwarteten Erträge des Projekts (in Form des „Net Present Value“, NPV), für das die Beihilfe gewährt wird (das faktische Szenario näheres hierzu im Template für das Project Portfolio), mit den erwarteten Erträgen des kontrafaktischen Szenarios verglichen werden. Zu diesem Zweck sollte das kontrafaktische Szenario mit einem hypothetischen Geschäftsplan nachgewiesen werden, der auf der gleichen Struktur basiert wie der für das Faktenszenario vorgesehene Geschäftsplan. Unter anderem werden folgende Angaben abgefragt:

- Erwartete Projektkosten
- Erwarteter Umsatz
- Steuerliche Effekte
- Beihilfen an anderen Standorten
- Terminal Value
- WACC (weighted average cost of capital)
- Terminal value

**Nicht Gegenstand** eines FOAK-Projektes sind:

- Projekte, die lediglich die Erweiterung bestehender Kapazitäten, die Kopie bereits bestehender Produktionen oder marktübliche Effizienz- und Produktivitätssteigerungen zum Inhalt haben.
- Projekte von Unternehmen, die Unternehmen in Schwierigkeiten im Sinne der Leitlinien der EK für staatliche Beihilfen zur Rettung und Umstrukturierung von Unternehmen bzw. der Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung sind).
- Projekte von Unternehmen, die Beihilfen rückzahlen müssen oder mussten, da diese von der EK als rechtswidrig und/oder unvereinbar eingestuft wurden.
- Projekte, die nicht explizit zu den Zielen der österreichischen Bundesregierung zur Stärkung der Halbleiterindustrie, oder nicht explizit zu den Zielen des European Green Deal beitragen, sowie Projekte, welche die Entwicklung klima- und umweltschädlicher Produkte zum Ziel haben.
- Projekte von Unternehmen, deren Investitionsstandort sich nicht in Österreich befindet.

# 4 Weiterführende Informationen

## Wichtige Links

Eine Vorlage für die Projektskizze und finden Sie auf der Chips-Act-[Webseite des BMAW](#).

Das Portal zum Upload der Projektskizzen finden Sie auf der [aws-Webseite](#).

Das Projekt Portfolio ([ausgefülltes Template](#)) als Interessensbekundung kann bis einschließlich 21. August 2023 17:00 Uhr, durch Verwendung des Upload-Tools an die Abwicklungsstelle der aws übermittelt werden via <https://datenraum.aws.at/url/infkkgujvf7rjdcq>

Es erfolgt eine Formalprüfung und eine inhaltliche Sichtung und Potenzialanalyse der eingereichten Projektskizzen, um die prinzipielle Eignung zur Notifizierung als First of A Kind Projekt.

## Rechtsgrundlage

Europäisches Chips Gesetz ([Annahme durch das Europäische Parlament erfolgte am 11. Juli 2023](#); die Annahmen durch den Rat der Europäischen Union erfolgt im September 2023)

Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union

## Beratung

Tabelle 2: Kontaktdaten zur Beratung

Name	Kontaktdaten
Wolfram Anderle (aws)	Telefon: +43 (1) 501 75 - 075 E-Mail:
Stella Mitsche (aws)	Telefon: +43 (1) 501 75 - 075 E-Mail:



**Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft**

Stubentor 1, 1010 Wien

[bmaw.gv.at](http://bmaw.gv.at)